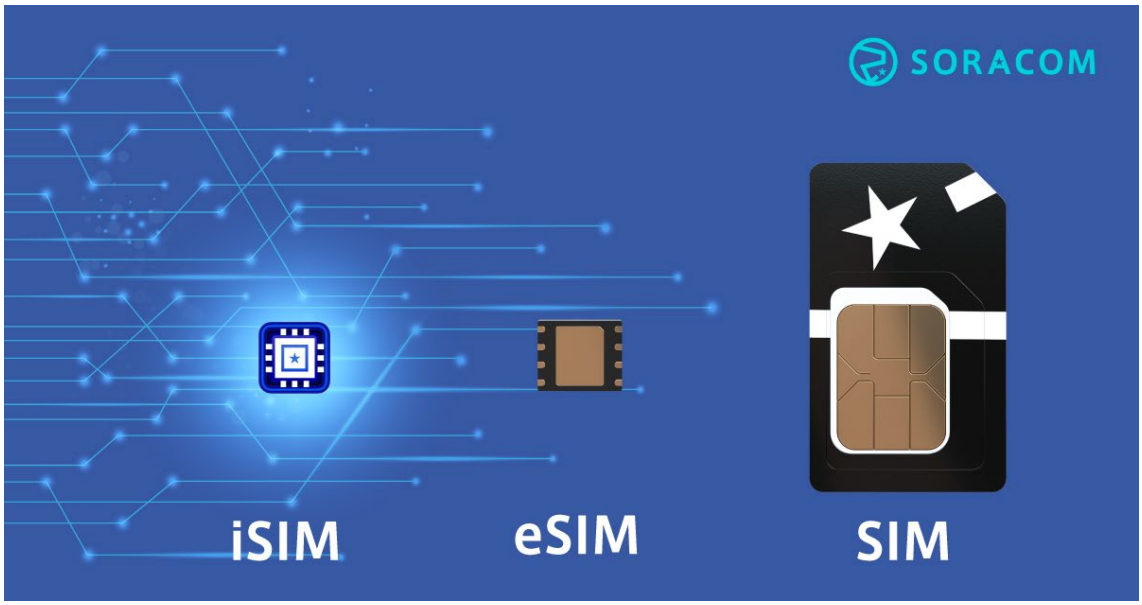
2024年10月30日

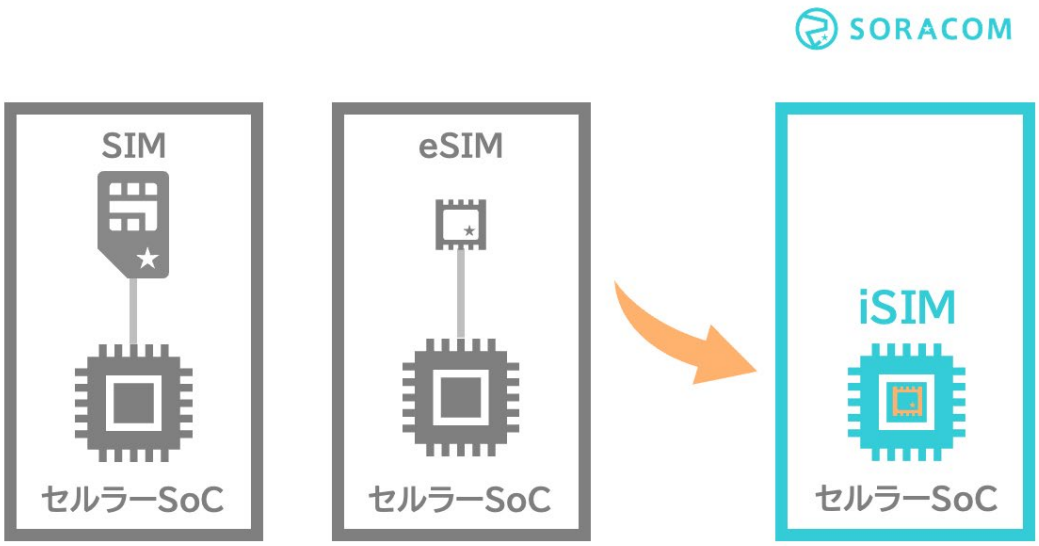
株式会社ソラコム

SIMカード、eSIMに次ぐ第3の形状のSIMである
次世代SIMテクノロジー「iSIM」を商用化、搭載モジュールを提供開始

株式会社ソラコム（本社：東京都港区、代表取締役社長　玉川憲）は、次世代SIMテクノロジーである「iSIM」を、データ通信サービス「SORACOM Air for セルラー」に対応するカード型SIM(*1)、チップ型SIM（Embedded SIM、eSIM）に次ぐ第3の形状のSIMとして商用提供を開始します。あわせて、2種類のiSIM搭載セルラー通信モジュールを2024年10月30日から提供します。



iSIM（Integrated SIM）は、従来は別々に存在していた通信モジュールとSIMの機能を、1枚のチップ（SoC：System-on-Chip）に統合した技術です。IoTデバイスの設計が簡素化され、小型・軽量化、省電力化が実現します。また、通信モジュールとSIMがワンストップになることで、デバイスの製造から販売のライフサイクルにおいて、部品調達や物流、保管コストを削減、環境負荷の低減も期待されます。



iSIMの商用化にあたり、ソラコムは、2021年7月より、セルラーIoT向けチップセットを開発するSony Semiconductor Israel Ltd. 、セルラーIoTデバイスにセキュアな認証情報を提供する「Kigen® セキュアiSIMオペレーティングシステム」開発及び供給元のKigenと共同でiSIMの商用利用を検証し、IoTプラットフォームSORACOMを他種のSIM形状と同様に統合的に管理できるように進化させてきました。

この度、正式にSORACOMのプラットフォームがiSIMに対応したことを発表し、搭載モジュール（量産向け）と評価ボードの提供を開始します。

iSIM対応モジュールとして、Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. の「BG773A-GL」と、株式会社村田製作所の「Type 1SC」の2種類が提供されます。これらのモジュールには、グローバルに対応した通信プラン「plan01s」がプリインストールされており、1枚のSIMとソラコムとの契約のみで、世界中のセルラーネットワークをシームレスに利用することが可能です。

また、これらのモジュールは、SORACOMの「サブスクリプションコンテナ」機能を活用して、OTA(*2)でサブスクリプション「planX3」を追加することができます。この「planX3」は、LPWAN通信（LTE-M、NB-IoT）向けに最適化されており、IoTデバイスの利用シーンに応じた柔軟な対応が可能です。また、従来のSORACOM IoT SIM同様に、IoTプラットフォームSORACOMの回線管理やデバイス管理、クラウド連携、データ収集など、IoTシステムの構築や運用をサポートするサービスも利用できます。

さらに、iSIMの搭載を検討されている方々には、iSIMモジュールを基板に実装することなく、スムーズに評価や検証を進めていただくための評価ボードキットもご用意しています。

ソラコムは、IoT活用をもっと身近にするべく、お客様、パートナー企業とともに社会やビジネスのイノベーションに貢献していきます。
(*1)Subscriber Identity Module：携帯電話事業者が加入者を識別するためのIDが記録されたICチップ。セルラーネットワークへの接続の認証に使われます。

(*2)Over the Air：セルラー通信経由で遠隔からSIMの設定をセキュアに書き換える技術。OTAでのサブスクリプション追加には、OTA動作確認済みモジュールを利用する必要があります。

iSIMの商用化にあたり、共同で取り組んだ4社からのコメント

当社とSORACOMおよびエコシステムパートナーとの長期的な協力関係により、IoTデバイスメーカーは、モジュールに統合された当社iSIMソリューションに「即時」アクセスが可能になり、製品の開発から製造までの時間が短縮され、グローバルコネクティビティに接続されるサービスから価値を引き出す能力がさらに向上します。これは、iSIMカタログを持つメーカーをスタートから量産までサポートする重要なマイルストーンとなります。

Kigen
CEO, Vincent Korstanje 氏

このエキサイティングなコラボレーションについて、パートナーに感謝の意を表したいと思います。この革新的なモデルを通じて、iSIMはLPWAチップセットをSORACOMネットワークにシームレスに接続し、お客様のハードウェア設計とオンボーディング体験を簡素化します。このアプローチは、低消費電力のセルラーIoTアプリケーションの採用を推進するために不可欠であり、IoTデバイスメーカーのエンゲージメントと満足度を大幅に向上させると考えています。

Sony Semiconductor Israel Ltd.
VP of Product Management and Marketing Dima Feldman氏

当社の超小型・低消費電力のiSIM対応セルラーLPWA通信モジュール「Type 1SC」を、SORACOMユーザ様向けに提供できることを嬉しく思います。
当社が長年培ってきた小型パッケージ技術にて実現した超小型モジュールとiSIM技術の組み合わせにより、より小型化のニーズにお応えし、かつIoTプラットフォームSORACOMと一体化した提供を実現できたことで、より多くのお客様が、簡単かつ迅速にIoTを活用したサービスを提供できる助けになると期待しております。当社は引き続き、世界中のデバイスがネットワークにつながるIoT活用サービスの実現に向けてお客様に寄り添いながら貢献していきます。

株式会社　村田製作所
通信モジュール事業部　コネクティビティモジュール商品部　部長　中江 広和氏

超低消費電力と強固なセキュリティを備えたLTE Cat M1/Cat NB1/NB2対応のLPWAモジュール「BG773A-GL」をSORACOMユーザーコンソールを通じて提供できることを大変嬉しく思います。当社のiSIM対応通信モジュールをSORACOMのネットワークと組み合わせることで、お客様は、統合されコスト効率の高い、持続可能で安全なIoTソリューションを大規模かつ容易に実現することができ、グローバルなIoT導入が合理化され、よりスマートな世界への道が開かれます。

Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.
SVP Sales APAC + ANZ Michael Wallon氏

iSIMの商用化、iSIM搭載モジュールの提供開始

提供開始日

2024年10月30日

製品詳細

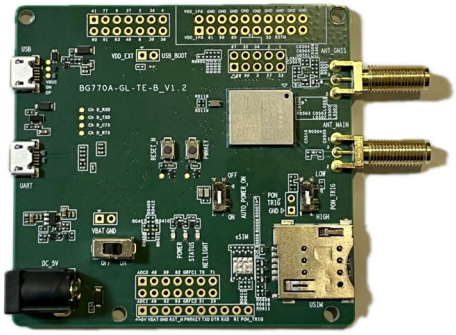
BG773A-GL(iSIM)

提供元:Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.



- 型番:BG773AGL02AA-16N-KSC
- 対応する通信規格:LTE-M/NB-IoT
- 提供形式:LGA(表面実装タイプ)のモジュールをリール形状で提供
- 価格
  - 500個　9,000 USD
  - 2000個　35,000 USD
  - SAMPLE 100個　2,800 USD
- 詳細:https://soracom.jp/store/29323/

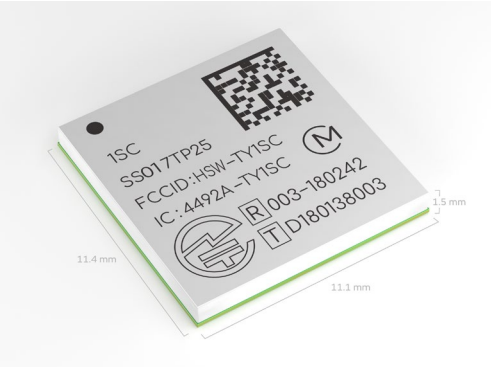
BG773A-GL-TE-B(iSIM)



- 型番:BG773AGLKSCTB-KIT
- 対応する通信規格:LTE-M/NB-IoT
- 付属物
    - LTE用アンテナ付属(1本)
- 提供形式:「BG773A-GL」を搭載した開発ボードキット
- 価格
    - 150 USD
- 詳細:https://soracom.jp/store/29509/

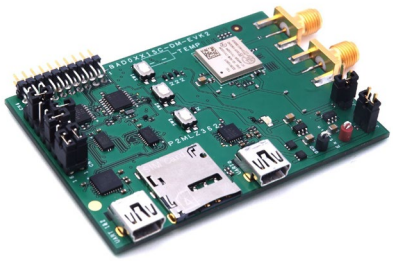
Type 1SC(iSIM)

提供元:株式会社村田製作所



- 型番:LBAD0XX1SC-713
- 対応する通信規格:LTE-M/NB-IoT
- 提供形式:LGA(表面実装タイプ)のモジュールをリール形状で提供
- 価格
    - 1000個　　19,500 USD
    - 2000個　　38,000 USD
- 詳細:https://soracom.jp/store/30618/

Type 1SC 評価キット（iSIM）



- 型番：LBAD0XX1SC-DMS-EVK-B
- 対応する通信規格：LTE-M/NB-IoT
- 付属物
    - ○ LTE用アンテナ付属（1本）
- 提供形式：「Type 1SC」を搭載した開発ボードキット
- 価格
    - ○ 300 USD
- 詳細：https://soracom.jp/store/30622/

利用できるSORACOM Air for セルラーのサブスクリプション

提供するモジュールは、いずれもLTE-M/NB-IoT対応のため、以下のサブスクリプションが利用できます。

plan01s：あらかじめプリインストールされているサブスクリプション
planX3：サブスクリプションコンテナ機能により、追加できるサブスプリクション

※ plan01s、planX3のLTE-M/NB-IoTの対応国は以下のウェブサイトをご確認ください
https://developers.soracom.io/en/docs/reference/carriers/

購入方法

- SORACOMユーザーコンソールにて、グローバルカバレッジを選択し、「発注」画面からご購入ください。

※ 価格はすべてUSDでの記載、税抜き、送料別です。
※ 本商品および「plan01s」を含むグローバルカバレッジの通信回線は、SORACOM CORPORATION,LTD.が提供します。
※ 一部の商品は受注生産となるため、納期にお時間をいただく場合がございます。ユーザーコンソールでの商品説明に記載の納期を必ずご確認ください。

ソラコムについて

IoTプラットフォームSORACOMは、世界180以上の国と地域でつながるIoT通信を軸に、IoTを活用するために必要となるアプリケーションやデバイスなどをワンストップで提供しています。製造、エネルギー、決済などの産業DXから、イノベーティブなスタートアップ、農業や防災など持続可能な地域社会を支える取り組みに至るまで、さまざまな業界・規模のお客様にご活用いただいています。
コーポレートサイト https://soracom.com

本ニュースに関するお問い合わせ

株式会社ソラコム 広報 田渕
pr@soracom.jp